# 平成23年3月期第2Q決算説明会

2010年 10月29日(金) 尼崎 11月4日(木) 東京

### メック株式会社

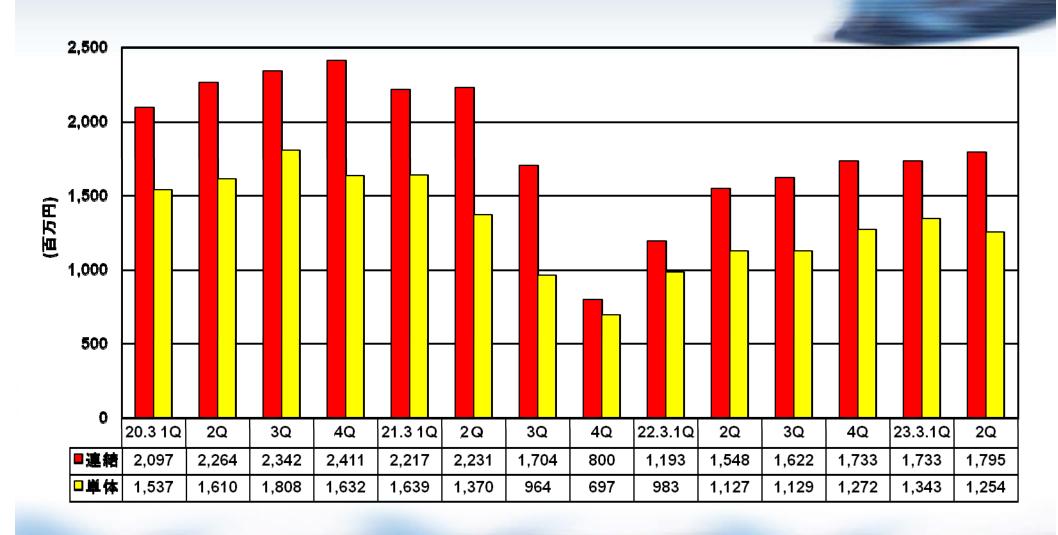
証券CODE:4971

URL http://www.mec-co.com/

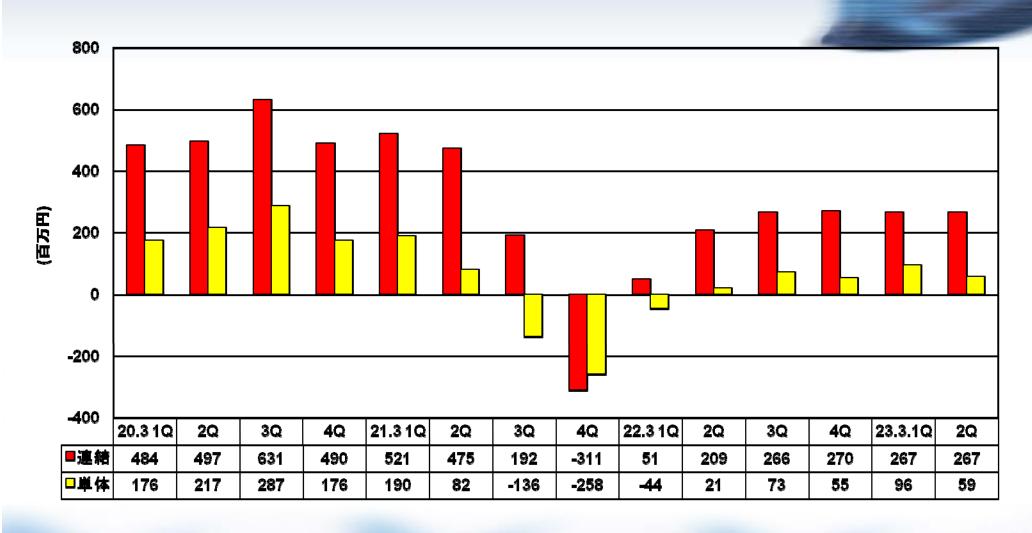
# 平成23年3月期第2Q業績のポイント

1)	売上高	35億69百万円	対前年比 30.2%増				
	営業利益	5億35百万円	対前年比 105.3% 増				
	経常利益	4億66百万円	対前年比 78.6% 増				
	純利益	3億40百万円	対前年比 48.7% 増				
<b>2</b> )							
2)	薬品売上高	31億35百万円	売上高に占める割合 87.8% [前年同期 25億67百万円、93.6%]				
2)							
3)	海外売上げ高比率	43.3%	前年同期 42.7%				
4.							
4)	CZの売上げ高	17億3百万円	薬品売上高に占める割合54.3% [前年同期14億24百万円、55.5%]				

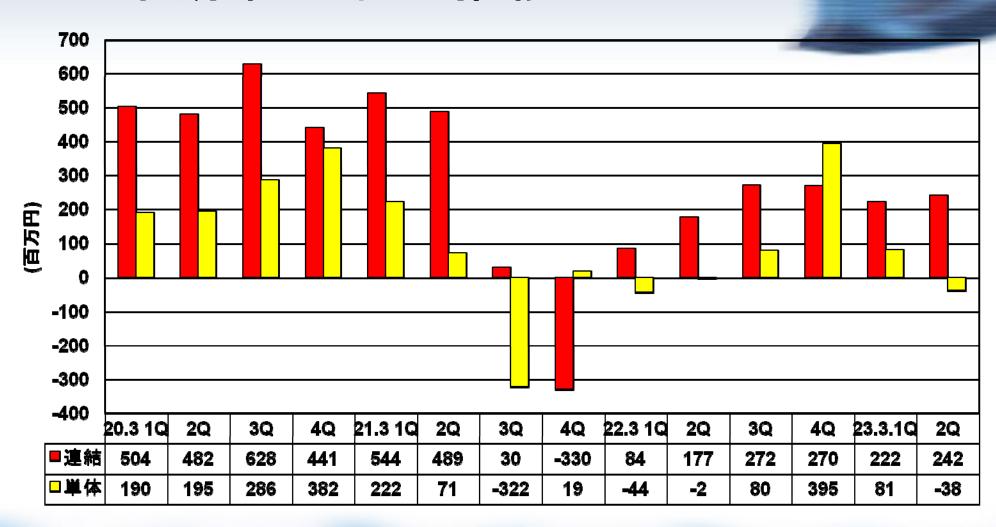
# 四半期 売上高推移



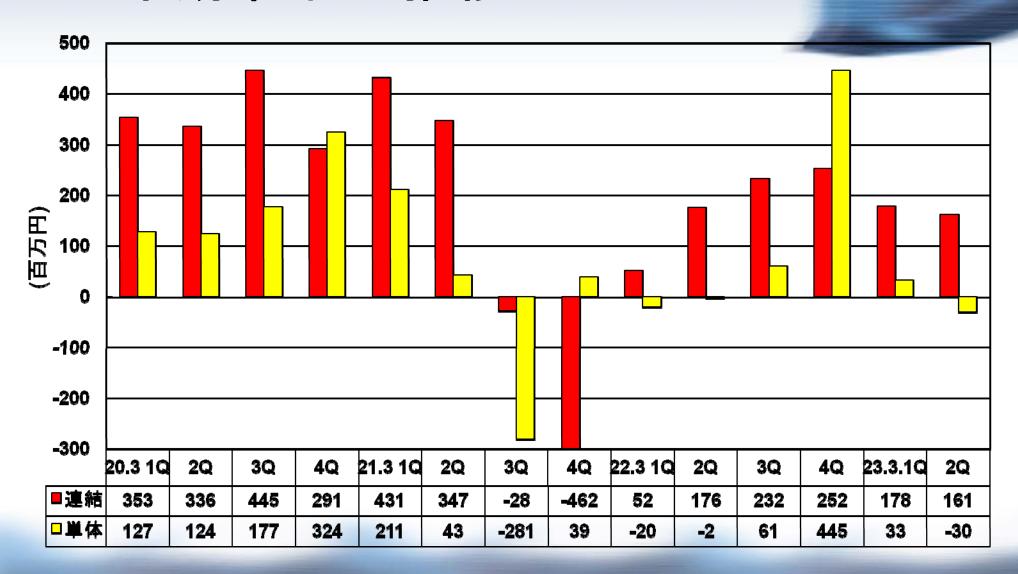
# 四半期 営業利益推移



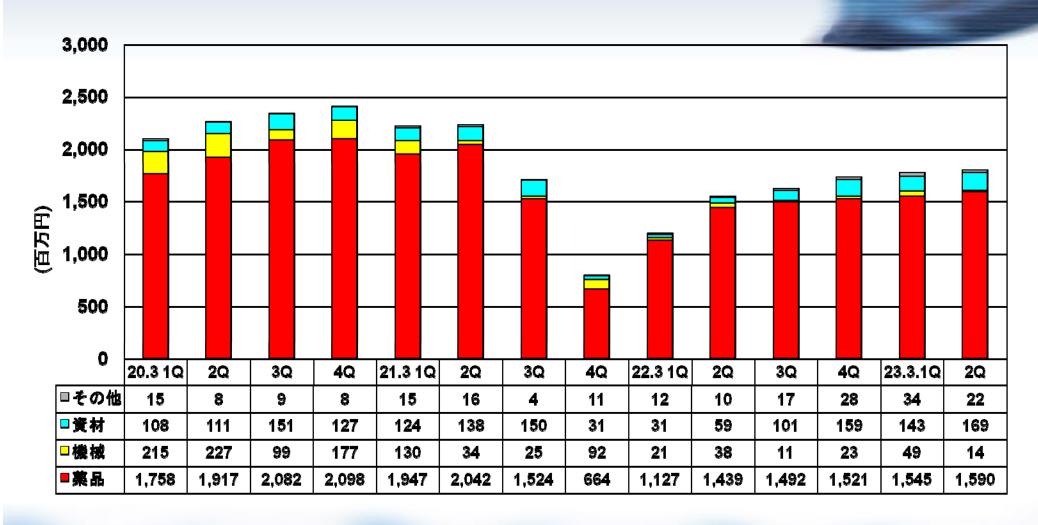
# 四半期 経常利益推移



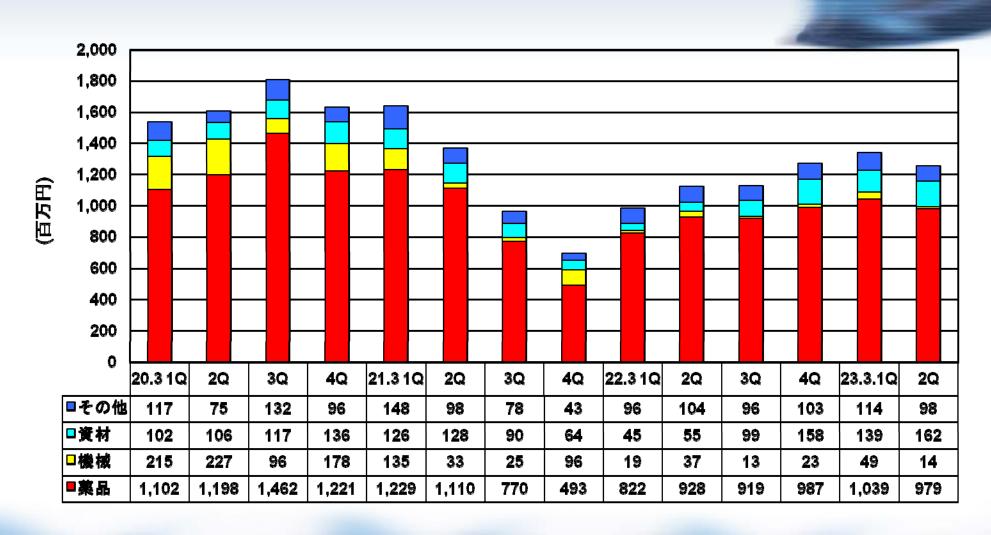
# 四半期 純利益推移



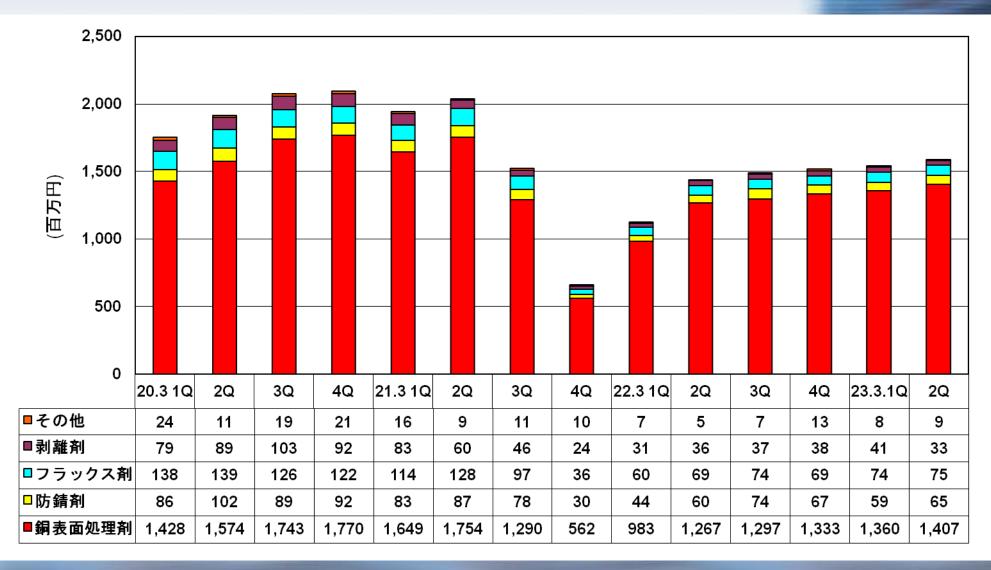
# 品種別四半期推移《連結》



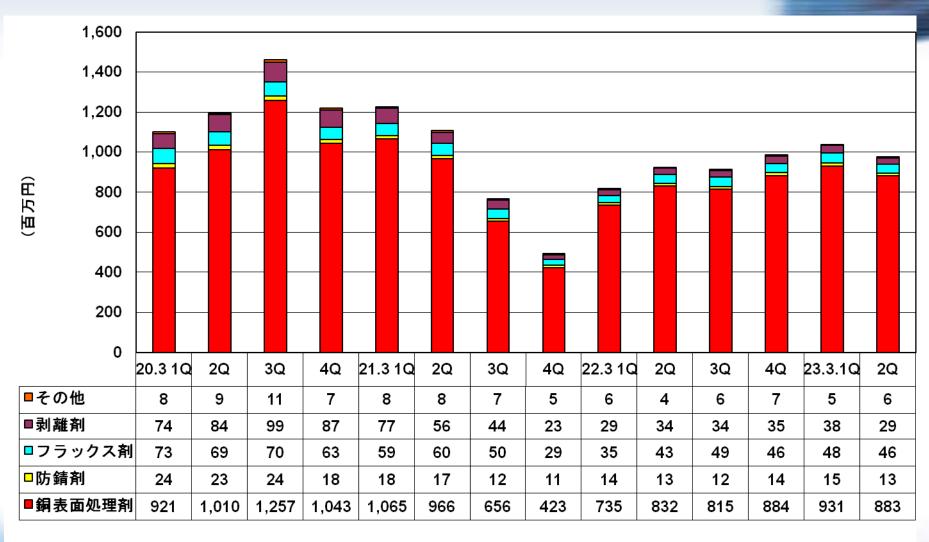
# 品種別四半期推移 <単体>



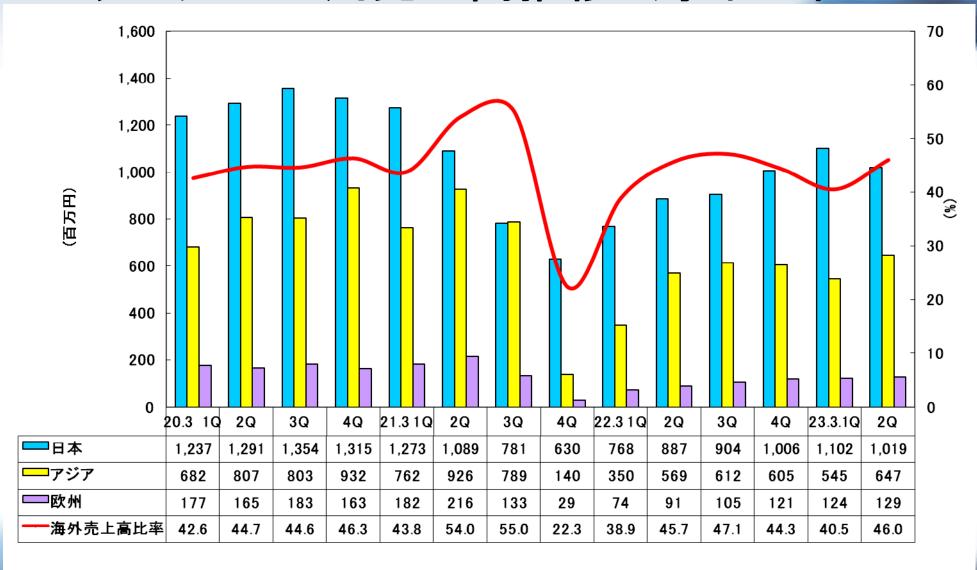
## 薬品別四半期推移《連結》



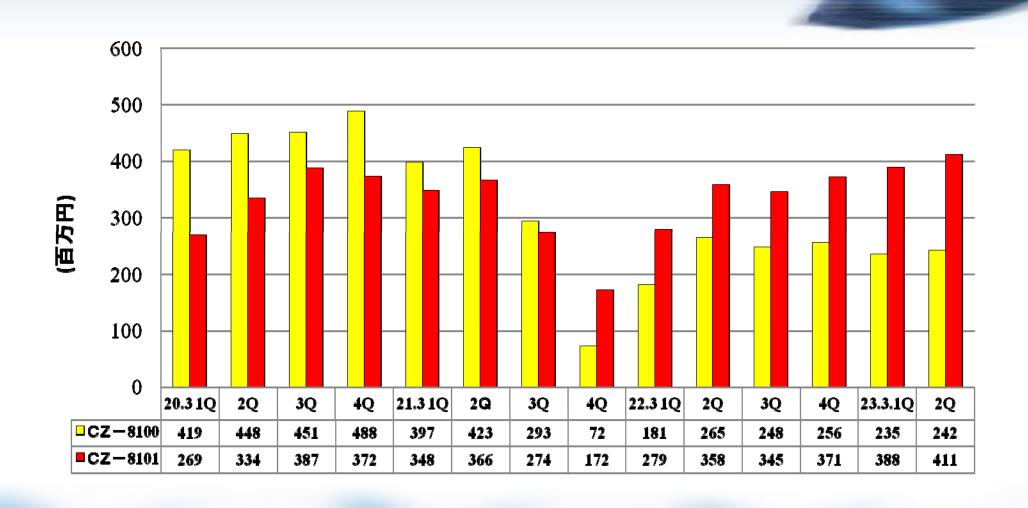
## 薬品別四半期推移 <単体>



### 地域セグメント別売上高推移と海外比率



# CZシリーズ売上高推移



# 第42期(平成23年3月期)計画

#### 連結

	平成22年3月期	平成23年3月期						
	前期実績	当初予算	修正予想	今期再修正予想	増減額			
売上高	6,098	6,885	7,314	6.881	112.8	783		
営業利益	798	1,098	1,305	978	122.5	179		
経常利益	804	1,060	1,264	852	105.9	47		
当期純利益	713	716	852	534	74.8	Δ179		

#### 単体

	平成22年3月期	平成23年3月期						
	前期実績	当初予算	修正予想	今期再修正予想	前期比	増減額		
売上高	4,512	5,021	5,482	4,987	110.5	474		
営業利益	105	305	517	232	219.5	126		
経常利益	429	570	779	409	95.4	Δ19		
当期純利益	482	487	629	352	73.0	Δ130		

数字単位は百万円、前期比は%。当初予算は5月14日、修正予想は7月26日、再修正予想は10月27日に公表。

### 新事業所については、 10月27日に建設の中断を発表

	設立	土地	床面積	生産能力	人員数	役割•概況
西宮 工場	1985年6月	4,065 m²	1,880 <b>m</b> ²	600t/月	20名	少量多品種生産 老朽化
長岡 工場	1993年5月	20,877 <b>m</b> ²	3,351 m <sup>2</sup>	1,800t/月	11名	大量生産
新事業所計画	2012年3月 予定	14,214 <b>m</b> ²	5,063㎡ 事務棟2,239㎡ 生産棟2.824㎡	200t/月	約90名(予定) 56名(本社) 11名(西宮) その他研究より MAX150名	本社と工場が一体、 研究所に近い集約効果 研究と連携した試作品や 少量品の製造。

#### 中断の理由

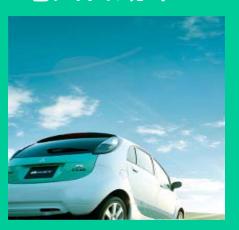
- 1.当社を取り巻く事業環境の大きな変化
- 2.新事業領域への投資の検討
- 3.円高を主要因とする 国内空洞化懸念

### 今後の見通し

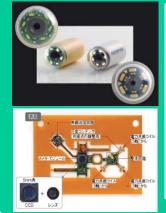
- 1.今期業績の影響は軽微
- 2.既存工場の有効活用
- 3.研究所機能の拡張と 業務効率化は組織の見直し等 で対応

### 今後拡大するアプリケーション

### 電気自動車



### 医療エレ



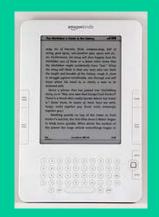


### スマートフォン





### 電子書籍

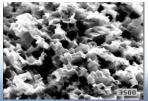


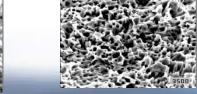


### 色々な金属表面処理(新市場用)

注意: 金属表面処理は、それぞれの状態により変化する可能性があります。

		金属表面処理											
		Cu	Ni	Sn	Al	Cr	Со	Мо	In	Bi	Та	Ni-Cr	ITO
	Cu		0	0	0	0	0					0	0
	Ni	0		0	0			0					
	Sn	0			0			0					
	Al	0					0	0	0	0			
台	Cr	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
崇	Со	0		0	0	0		0				0	0
曹	Мо	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
金属表面非処理	In	0		0	0			0					
lum.	Bi	0		0	0			0					
	Та	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
	Ni-Cr	0	0	0	0		0	0					
	ITO	0	0	0	0		0	0	0	0	0		





アルミ表面

ニッケル表面

## 今後の計画ポイント

- 1. 高密度電子基板量産用新プロセスの実用化
- 2. 多層電子基板製造用プロセスを通じて、客先の環境負荷低減に寄与する取組み
- 3. 銅表面処理から金属表面処理へ。様々な用途への適用を目指す